

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy.

Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięć w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	System magistrali szyny montażowej, Profil pokrywy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 750 mm
Nr zam.	1248270000
Typ	CH20M BUS-ADP TS 35/750
GTIN (EAN)	4050118052985
Ilość	5 szt.

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	7 mm	Głębokość (cale)	0.2756 inch
Wysokość	39.5 mm	Wysokość (cale)	1.5551 inch
Szerokość	750 mm	Szerokość (cale)	29.5275 inch
Długość	0 mm	Masa netto	64 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 6	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI	Moisture Level (MSL)	
Klasa palności wg UL 94	V-0	Temperatura pracy, max.	120 °C

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	PA 6
grupa materiałów izolacyjnych	IIIa	Powierzchnia	nieobrobiony
Materiał podstawowy	tworzywo sztuczne	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI

Dane ogólne

Barwny	czarny	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Szyba montażowa	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15	Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

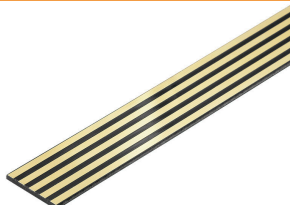
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

CH20M BUS - płytki drukowane magistral bus



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięc w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/750	Wersja
Nr zam.	1248240000	System magistrali szyny montażowej, Karta magistrali, Obudowy
GTIN (EAN)	4050118053210	OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 750 mm
Ilość	5 ST	

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Profil wkładki Bus - TS35x15



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięc w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Wersja
Nr zam.	1248210000	System magistrali szyny montażowej, Profil przylgowy, Obudowy
GTIN (EAN)	4050118053241	OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 25.3 mm
Ilość	5 ST	

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Profil wkładki Bus - TS35x7,5



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięc w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X...	Wersja
Nr zam.	1248170000	System magistrali szyny montażowej, Profil przylgowy, Obudowy
GTIN (EAN)	4050118053272	OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 750 mm
Ilość	5 ST	

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

CH20M BUS -AP - płytki końcowe profilu wkładki Bus



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięc w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyną nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M BUS-AP LI TS 35X7...	Wersja
Nr zam.	1193160000	System magistrali szyny montażowej, Płyta zamykająca, Obudowy
GTIN (EAN)	4032248987771	OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 5.1 mm
Ilość	50 ST	
Typ	CH20M BUS-AP RE TS 35X7...	Wersja
Nr zam.	1193170000	System magistrali szyny montażowej, Płyta zamykająca, Obudowy
GTIN (EAN)	4032248987924	OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 5.1 mm
Ilość	50 ST	

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

blok stykowy magistrali - środkowy kołnierz lutowany



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięc w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3...	Wersja
Nr zam.	1155870000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942510	kołnierz środkowy lutowany, Połączenie lutowane THT/THR,
Ilość	78 ST	Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, pozłacany, czarny
Typ	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3...	Wersja
Nr zam.	1155880000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942305	kołnierz środkowy lutowany, Połączenie lutowane THT/THR,
Ilość	300 ST	Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, pozłacany, czarny

CH20M BUS-ADP TS 35/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

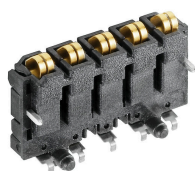
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

blok stykowy magistrali - kołnierz lutowany



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięc w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	Wersja
Nr zam.	1155890000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942527	kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów:
Ilość	78 ST	5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, połączony, czarny
Typ	SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...	Wersja
Nr zam.	1155900000	Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M12-67,
GTIN (EAN)	4032248942381	kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów:
Ilość	300 ST	5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, połączony, czarny